

<<现代电镀手册（下册）>>

图书基本信息

书名：<<现代电镀手册（下册）>>

13位ISBN编号：9787111344131

10位ISBN编号：7111344138

出版时间：2011-7

出版时间：机械工业

作者：沈品华 编

页数：2128

字数：3271000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代电镀手册（下册）>>

内容概要

沈品华主编的《现代电镀手册》分上下两册，共27篇。

上册除总论外，有8篇：电镀清洁生产、电镀化学基础、电镀电化学基础、普通金属电镀（包括镀前处理、电镀挂具、8种单金属电镀工艺和刷镀工艺）、镀贵金属和贵金属合金、特种材料上电镀、电镀合金以及复合电镀，还有相关资料附录。

下册19篇：电子电镀、化学镀、稀土添加剂在表面处理中的应用、电铸、铝和铝合金的表面氧化处理、金属表面的花色处理、金属的化学氧化和磷化、机械镀、达克罗涂覆层和烧结锌涂层、热浸镀、电泳涂装、电镀溶液性能测试、镀层性能测试、转化膜性能测试、现代检测仪器的应用、电镀溶液分析方法、电镀车间设计、电镀纯水的制备、电镀废水、废渣和废气的处理等。

《现代电镀手册》荟萃和网罗了国内外先进的电镀及相关工艺、材料、工装、电镀清洁生产技术和电镀废水、废渣和废气处理方法与装置，既是一本大型工具书，又是一篇论述详尽的专论，其内容丰富，深入浅出，实用性强、可靠性好，可供电镀工程技术人员、生产操作工人和教育、科研及设计单位等有关人员参考。

<<现代电镀手册（下册）>>

作者简介

沈品华 上海永生助剂厂厂长，高级工程师 现兼任全国金属与涂饰标准委员会委员
中国表面工程协会常务理事和电镀分会副理事长 特种涂层专业委员会常务副理事长 电镀老专家工作委员会副主任
《材料保护》和《腐蚀与防护》杂志编委 电镀历程与成就 从事电镀工作55年，是无氰电镀工艺的创导者，至今未退休。

工人出身的技术人员，每次都被破格提拔，直到晋升为高级工程师。
1969年在国内最早投产氯化铵镀锌。

1974年又率先投产镀锌层低铬钝化。

拥有上百项科研成果，最近又试验成功了我国电镀助剂行业的软肋——硫酸镀铜光亮剂，性能可与国外最佳同类光亮剂媲美。

参与4本书的编写，发表论文90多篇，翻译过20多万字的技术资料。

上海市三学状元。

三次被评为上海市劳动模范。

荣获全国五一劳动奖章。

享受政府特殊津贴。

被慧聪网评为表面处理行业十大新闻人物。

<<现代电镀手册（下册）>>

书籍目录

序

前言

编者的话

第1篇 电子电镀

第1章 芯片铜互连电镀技术

1 概述

2 铜互连电镀的基本工艺及要求

3 电镀铜互连技术

3.1 硫酸盐镀铜溶液的基本组成及各成分的作用

3.2 有机添加剂的作用机理

3.3 铜互连用硫酸铜镀液配方

3.4 超等厚生长模型

3.5 添加剂浓度的检测

3.6 先进的电镀铜技术

4 化学镀铜互连技术

5 化学置换法

6 专用电镀设备

7 电镀液的维护与管理

第2章 接插件电镀技术

1 概述

2 接触体镀金

2.1 镀液配方组成

2.2 工艺流程

2.3 镀液配制方法

2.4 镀液中各成分的作用及操作条件的影响

2.5 镀液的维护方法

2.6 镀液故障处理

3 接触体的其他电镀

3.1 镀银

3.2 镀锡

3.3 镀钯

4 接插件外壳电镀

4.1 镀锌

4.2 镀镉

4.3 镀镍

5 可伐合金接插件电镀

第3章 印制板电镀技术

1 概述

1.1 印制板的概述

1.2 印制板的类型

1.3 印制板的电镀

2 印制板化学镀铜

2.1 化学镀铜工艺过程

2.2 前处理

2.3 化学镀铜

<<现代电镀手册（下册）>>

- 2.4 孔金属化常见的故障及排除方法
- 3 印制板电镀铜
 - 3.1 概述
 - 3.2 镀液配方及操作条件
 - 3.3 镀液中各成分的作用
 - 3.4 操作条件的影响
 - 3.5 镀液维护方法
 - 3.6 镀液常见故障及排除方法
- 4 印制板的图形电镀
- 5 高密度互连板的孔金属化与电镀
 - 5.1 高密度互连板
 - 5.2 高密度互连板电镀技术
- 6 高多层板的孔金属化与电镀
- 7 结束语

参考文献

- 第2篇 化学镀
- 第3篇 稀土添加剂在表面处理中的应用
- 第4篇 电铸
- 第5篇 铝和铝合金的表面氧化处理
- 第6篇 金属表面的花色处理
- 第7篇 金属的化学氧化合磷化
- 第8篇 机械镀
- 第9篇 达克罗涂覆层和烧结锌涂层
- 第10篇 热浸镀
- 第11篇 电泳涂装
- 第12篇 电镀溶液性能测试
- 第13篇 镀层性能测试
- 第14篇 转化膜性能测试
- 第15篇 现代检测仪器的应用
- 第16篇 电镀溶液分析方法
- 第17篇 电镀车间设计
- 第18篇 电镀纯水的制备
- 第19篇 电镀废水、废渣和废气的处理

参考文献

附录

章节摘录

版权页：插图：接插件是指通过某种可接插式结构形成电路之间互连的电子器件。

在我国，接插件一词常泛指包括连接器、插头、插座、接线柱、管座及开关等在内的所有器件。

但是近年来，已逐渐将接插件与连接器两个词语等同。

接插件或连接器主要是应用于各种电子和电气线路中作为电源的连接和电信号传输的连接器件。

它广泛地应用于各种电子、电气的连接中，如用于集成电路（IC）封装引脚与印制板（PCB）的连接、印制板与印制板的连接、底板与底板的连接、设备与设备的连接等。

目前接插件已广泛应用于计算机、通信设备、航空、航天、家电和汽车电子等各种领域。

接插件的基本构件主要有：接触体、外壳、绝缘体和其他附件。

接触体是实现电路导通传输信号或电源的部件，它一般包括插针（插件）和插孔（接件）两部分。

外壳（或称壳体）是接插件的外罩，用于支撑接触体等部件，并实现插针与插孔插合时的对准和固定

。

绝缘体主要是用来分开多个接触体并提供接触体之间以及接触体与外壳之间绝缘的部件。

其他附件是可能有的其他辅助部件，如密封圈、卡圈、密封垫及螺母、螺杆等。

在接插件的各部件中，接触体和外壳都需要进行电镀加工。

<<现代电镀手册(下册)>>

编辑推荐

《现代电镀手册(下册)》：作者队伍精：作者是一批来自企业、高校、研究所的具有各方面电镀专长的专家和教授。

正是这支权威的作者队伍使本手册内容翔实、指导性强。

技术工艺新：内容新颖、实用，在继承原有技术的基础上增加了新工艺、新方法，能够反映当前国内外的先进工艺水平。

实用性能强：能对电镀技术人员和现场操作工人从原理到实践，深入浅出地起到参考和指导作用，犹如一位“咨询师”常伴随在读者身旁。

涵盖内容广：内容全面，涵盖面广，镀种和各种金属（包括某些非金属）的表面处理方法齐全。

不仅包括电镀工程中设备、工艺配方和废水治理等所有内容，还涉及以往出版书籍中没有提到或很少提到过的镁合金、钨铁硼材料等的电镀工艺，以及电子电镀、合金电镀、稀土在表面处理中的应用、清洁生产、电铸、刷镀、机械镀、锌铬膜、锌铝膜、热镀锌等相关内容。

<<现代电镀手册（下册）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>